

会 社 名 **株式会社サムコインターナショナル研究所**

登録銘柄 (店頭登録銘柄)

コード番号 6387

本社所在都道府県 京都府

(URL <http://www.samco.co.jp>)

本 社 所 在 地 京都府京都市伏見区竹田藁屋町 36 番地

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 辻 理

問 合 せ 先 責 任 者 取 締 役 管 理 本 部 上 席 指 導 役 山 田 史 郎

T E L ( 0 7 5 ) 6 2 1 - 7 8 4 1

決 算 取 締 役 会 開 催 日 平 成 1 6 年 9 月 1 7 日

中 間 配 当 制 度 の 有 無 有

定 時 株 主 総 会 開 催 日 平 成 1 6 年 1 0 月 2 2 日

単 元 株 制 度 採 用 の 有 無 有 ( 1 単 元 1, 0 0 0 株 )

1. 16 年 7 月期の業績 (平成 15 年 8 月 1 日 ~ 平成 16 年 7 月 31 日)

(1) 経営成績 (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 7 月期	3,374	( 1.8 )	434	( 4.3 )	411	( 4.3 )
15 年 7 月期	3,435	( 15.8 )	416	( 0.4 )	395	( 8.9 )

	当 期 純 利 益		1 株 当 た り 当 期 純 利 益	潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益	株 主 資 本 当 期 純 利 益 率	総 資 本 経 常 利 益 率	売 上 高 経 常 利 益 率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
16 年 7 月期	251	( 13.5 )	50 71		5.2	5.8	12.2
15 年 7 月期	221	( 8.6 )	44 53		4.7	5.5	11.5

- (注) 1. 持分法投資損益 16 年 7 月期 百万円 15 年 7 月期 百万円  
 2. 期中平均株式数 16 年 7 月期 4,889,140 株 15 年 7 月期 4,889,140 株  
 3. 会計処理の方法の変更 無  
 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

	1 株 当 た り 年 間 配 当 金			配 当 金 総 額 ( 年 間 )	配 当 性 向	株 主 資 本 配 当 率
	円 銭	中 間 円 銭	期 末 円 銭			
16 年 7 月期	15 00		15 00	73	29.6	1.5
15 年 7 月期	12 50		12 50	61	27.6	1.3

(3) 財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1 株 当 た り 株 主 資 本
	百万円	百万円	%	円 銭
16 年 7 月期	6,997	4,982	71.2	1,018 48
15 年 7 月期	7,184	4,746	66.1	970 01

- (注) 1. 期末発行済株式数 16 年 7 月期 4,889,140 株 15 年 7 月期 4,889,140 株  
 2. 期末自己株式数 16 年 7 月期 1,750 株 15 年 7 月期 1,750 株

(4) キャッシュ・フローの状況

	営 業 活 動 に よ る カ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	投 資 活 動 に よ る カ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	財 務 活 動 に よ る カ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16 年 7 月期	405	69	407	1,170
15 年 7 月期	88	154	308	1,244

2. 17 年 7 月期の業績予想 (平成 16 年 8 月 1 日 ~ 平成 17 年 7 月 31 日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 年 間 配 当 金		
				中 間	期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中 間 期	1,800	265	155			
通 期	4,400	750	445	12 50		12 50

(参考) 1 株 当 た り 予 想 当 期 純 利 益 ( 通 期 ) 9 0 円 3 4 銭

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる場合があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、添付書類の 7 ページを参照してください。

## 添付書類

### 1. 企業集団の状況

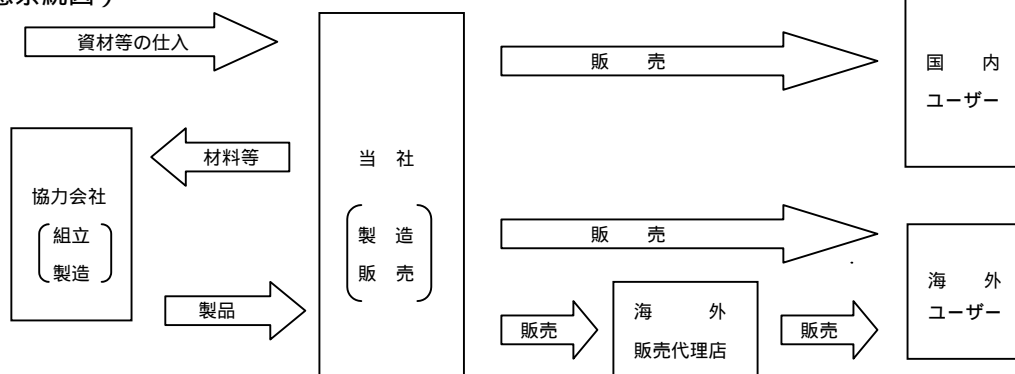
当社は、単独で事業を営んでおり、関係会社はありません。

当社は、半導体等電子部品製造装置メーカーで、薄膜形成・加工装置の製造及び販売を事業としております。当社の基本となる薄膜形成技術はCVD法（Chemical Vapor Deposition = 化学的気相成長法）によるもので、当社の各装置においては、ナノテクノロジーと言われる10nm～100μmまでの成膜や加工が可能であります。（nm = ナノメートル：10億分の1メートル μm = マイクロメートル：1百万分の1メートル）

当社の製品は、薄膜を形成するCVD装置、薄膜を微細加工するエッチング装置、基板表面などをクリーニングする洗浄装置、その他装置等に区分されます。

当社の装置の製造に関しては、自社の設計企画により協力会社に製造を委託し、製品出荷の前に独自のプログラムソフトを入力し、仕様検査・出荷検査を経て販売しております。販売に関しては営業所を通じて行うとともに、海外については一部現地販売代理店に委託しており、これらの関係を図示すると以下の通りとなっております。

（業態系統図）



当社は装置等を以下の通りに区分しております。

#### （CVD装置）

反応性の気体を基板の上に堆積させる装置で、一般に減圧下で半導体の絶縁膜、光学薄膜などを形成するために使われます。特に当社は発火性のガスを使用しない液体原料を活用したLS-CVD装置（LS = Liquid Source）に特徴があり、比較的低温反応で成膜速度が速く、均一性の良い成膜が可能です。

#### （エッチング装置）

各種半導体の基板の膜をはじめ微細加工に必要な材料を切削加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻していくものです。当社はICP（Inductive Coupled Plasma = 高密度プラズマ）を利用したエッチングに特徴があり、高速でかつ均一性の優れた加工が可能です。

#### （洗浄装置）

当社の装置は溶液を使用しないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて洗浄するところに特徴があります。高速で自動運転が可能であるため、高集積化を要求されるフィルム状実装基板などに使用されております。

#### （その他装置）

上記装置には含まれない特別な装置であります。

#### （その他）

部品、保守メンテナンスなどがあります。

## 2. 経営方針

### (1) 経営の基本方針

当社は「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」ことを経営理念とし、社員の創造性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。直販制度を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。事業が社会に果す役割を積極的に認識し、高い付加価値の追求を目標とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。を経営方針に掲げ、事業を展開しております。

### (2) 利益配分に関する基本方針

当社は株主の皆様への利益還元を経営の重点政策として位置付けております。経営体質の強化と将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、安定配当を継続していくことを基本方針としております。尚、当社は、本年設立 25 周年を迎え、業績も順調に推移いたしておりますことから、株主各位に感謝の意を表するため、平成 16 年 9 月 17 日開催の取締役会において平成 16 年 10 月 22 日開催予定の第 25 回定時株主総会に設立 25 周年記念配当を付議することを決議いたしました。普通配当の 12 円 50 銭に設立 25 周年記念配当の 2 円 50 銭を加え 1 株につき 15 円 00 銭の配当を実施する予定であります。

### (3) 投資単位の引き下げについて

当社は、当社株式の流動性の向上と株主数の増加を資本政策上の重要な課題と認識しております。特に 1 単元株式数の見直しによる株式投資単位の引き下げにつきましては、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるために実行すべき課題として認識しております。依って、平成 16 年 9 月 17 日開催の取締役会において平成 16 年 12 月 1 日付をもって 1 単元の株式の数を 1,000 株から 100 株に変更することを決議いたしました。

### (4) 中期的な会社の経営戦略

当社は化合物半導体を中心としたオプトエレクトロニクス分野に経営資源を集中しながら、中期的には次の 3 点について戦略を展開してまいります。第一は、既に各種バックライトとして実用化の盛んな白色および青色 LED (Light Emitting Diode = 発光ダイオード) や次世代大容量光ディスク用途向けに注目されている青色 LD (Laser Diode = 半導体レーザー) の量産化への対応及び各種センサーやチップが日々開発されて拡大している各種電子部品分野等への対応のため、本格的な量産用装置を開発し、メンテナンスを含めた販売力を強化していくこととあります。第二は、これらの分野も含めて、量産用と研究開発用が同時進行で拡大すると予想されている中国市場への積極展開であります。中国市場では既に商社と提携している一方、今後は独自の販売事務所の設置も視野に入れ、販売員の確保とサービス体制の確立を計画しております。第三は、CVD 装置、エッチング装置、洗浄装置といった当社の三大製品群に匹敵する IT 分野の第四の柱を確立することとあります。当社は、米国シリコンバレー、英国ケンブリッジとの 3 極体制で行っている研究開発と国内の大学や各種クラスターとの共同研究を行っておりますが、これらの中から、薄膜事業に関連する新事業、新分野をいち早く立ち上げ、当社の中期的な事業拡大に寄与する事業に成長させたいと考えております。また、当社は、創業以来「株式会社サムコインターナショナル研究所」の商号で事業を営んでまいりましたが、当社の営む事業が研究開発分野に加え量産機分野へと拡大していること、設立 25 周年の今年、社内外へ新たな成長に向けての決意を表明し、新しい企業イメージをアピールするため、平成 16 年 12 月 1 日付で新商号「サムコ 株式会社」へ変更する予定であります。

### (5) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

当社では、効率的で健全な企業経営システムを構築する上で、コーポレート・ガバナンスの確立は極めて重要な経営課題であると認識しており、常に組織の見直しと諸制度の整備に取り組んでおります。株主総会は、設立時からの 7 月決算を貫くことにより、参加しやすく開かれた総会を目指しており、また取締役会は、意思決定の迅速化と経営責任を明確化するため、月 1 回以上の開催を定例化し、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項の決定を行うとともに、監査役の参加のもと、業務の執行状況を管理監督しております。当社の取締役は 6 名ですが、常に次世代を担う若手役員候補者を育成しながら、開かれた運営を基本としております。当社は監査役制度を採用しておりますが、監査役 3 名は全員社外監査役であり、取締役の職務執行の適法性と妥当性をチェックし、公正な意見が発言できる仕組みを作り上げております。監査役 3 名のうち中野淑夫氏は、当社の顧問会計士です。木村隆之氏及び藤岡孝雄氏と当社との間に取引関係その他の利害関係はありません。尚、

今後監査体制の一層の強化を図るため1名増員し4名体制とする予定です。内部統制については、社長室が年間計画に基づく業務監査を実施して、内部牽制の実効性を高めております。今後も、経営内容の透明性を高め各ステークホルダーから信頼される企業を目指して、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。

#### (6) 対処すべき課題

##### 現状の認識について

現在、デジタル家電関連を中心に旺盛な設備投資が続く中、白色および青色LED、LDが牽引役となるオプトエレクトロニクス市場では、今後自動車関連部品や一般照明用に巨大市場の出現が予想されます。また、液晶に代わる次世代のディスプレイとして期待される有機EL(Electro Luminescence)用途などの表示デバイス分野や三次元実装などで高性能化を進める電子部品分野での需要の拡大が見込まれます。これまで当社装置の中心的用途となっていた研究開発用途に加え生産用途としての量産用装置の開発と販売・メンテナンス体制の確立を急ぐことが重要と考えております。また、これらの展開はグローバル化しており、特に中国市場は重点市場として早急に販売体制を確立する必要があると認識しております。

##### 当面の対処すべき課題の内容

当面の課題は前期に投入致しましたオプトエレクトロニクス市場向け量産用CVD装置とマイクロマシン市場向けに独口パート・ボッシュ社より技術導入致しました「ボッシュプロセス」を取り入れたICPドライエッチング装置の性能向上と販売力強化であります。また、オプトエレクトロニクス分野のLED、LD用途向けの新型MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition)装置の開発も重点的課題であります。そのためには、経営資源の集中とより一層の人材育成が必要であると考えております。

##### 対処方針

量産用装置の本格的開発と販売力強化はスケジュール通り実行中ではありますが、適材適所の人材については、スキル保有人材を中心に各方面に広く門戸を開放し、中途採用を強化するとともに、独自の社内研修システムを確立していく方針であります。

##### 具体的な取組み状況等

重点部門に的を絞った中途採用人材の募集のみならず、広く業務提携についても検討中であります。ただし、先方の技術力の評価と当社の業容との相乗効果を考慮しながら決定していく方針であります。中国市場要員としては既に2名の採用と現地派遣社員として1名確保済みであります。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 当期の概況

当期のわが国経済は、輸出を起点とした企業の生産活動が活発化し、旺盛なデジタル家電関連需要や株式市場の回復感から個人消費も底堅さを増し、内需の拡大が期待される展開となりました。

当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、薄型 TV、デジタルカメラ、DVD レコーダーなどのデジタル家電関連を中心とした電子部品分野の大型設備投資が国内外で活発化したしました。また、オプトエレクトロニクス分野では、高輝度 LED が、携帯電話をはじめ各種バックライト・自動車関連部品・信号機用途として更に需要が拡大する展開となりました。

こうした環境の中、当社は、白色および青色 LED や LD などの光源用途とレンズ用途を柱とするオプトエレクトロニクス分野向けと、各種センサー用途やマイクロマシン用途を中心とする電子部品分野向けの販売が、CVD 装置、洗浄装置ともに堅調に推移いたしました。また、海外向けでは、上半期に北米東海岸でナノテク関連用途を中心に MIT(マサチューセッツ工科大学)や現地メーカー数社からの受注が相次ぎ、欧米の装置メーカーと比較し当社装置の性能の高さが評価されました。下半期には台湾向けに LED 用途での受注が復活いたしました。製品開発では、各種デバイス材料として用途が拡大する化合物半導体分野向けに量産用 CVD 装置を開発し、微細化・高精度化が進展するマイクロマシン分野や電子部品分野向けに、独口バート・ボッシュ社よりの技術(ボッシュプロセス)導入でシリコンの高速ディープエッチング(深掘)装置を開発するなど成長分野に的を絞った積極的な研究開発活動を推進いたしました。また、当社とキリンピール株式会社で共同開発したペットボトル内壁への炭素薄膜コーティング技術が、ライセンス供与されておりました三菱重工業株式会社によって実用化されることになりました。前期に引き続き、仕入原価や製造原価などのコスト削減にも努めました。

以上のような活動をしてまいりました結果、当期は、装置の総販売台数が前期の 136 台から 153 台へと増加したものの中小型装置の販売が多く売上高は 3,374,507 千円(前期比 1.8%減)に留まりました。しかし、経常利益は、上半期に実施した製品価格の見直しが浸透したことと、利益率の良い生産用装置のリピートオーダーが増えたことにより 411,881 千円(前期比 4.3%増)となりました。また当期純利益も、試験研究費の税額特別控除が適用される等あり 251,227 千円(前期比 13.5%増)となりました。

#### (CVD 装置)

オプトエレクトロニクス分野でデジタルカメラ等に搭載されるマイクロレンズ成型過程で使用される薄膜形成量産装置やマイクロマシンの研究開発用途向けの需要が回復致しました。また、三次元実装における層間絶縁膜の形成用途等で当社の得意とする液体原料を使用する大型 CVD 装置の受注が獲得できました。FPD(Flat Panel Display)分野でも有機 EL の封止膜用途で受注実績ができ、売上高は 816,483 千円(前期比 26.7%増)と増加致しました。

#### (エッチング装置)

電子部品加工用や石英ガラスのエッチングで特に研究開発用として使い勝手が良い小型装置の RIE - 10NR が根強い人気を受け受注が順調に伸びました。一方で、オプトエレクトロニクス分野の光源部門において、青色 LED の生産に不可欠な GaN(窒化ガリウム)の大型エッチング装置として ICP 型装置の市場評価は定着したものの予想以上の価格競争となり利益率重視の販売姿勢から、売上高は 1,729,067 千円(前期比 16.9%減)となりました。

#### (洗浄装置)

従来の BGA(Ball Grid Array = 表面実装アレーの一種)基板の洗浄用途に加え青色 LED 実装前のクリーニング用途、マイクロレンズ成型過程用途や有機 EL 等表示デバイスの表面処理用途での受注が好調で、売上高は 429,233 千円(前期比 31.4%増)となりました。

#### (その他装置)

当期の売上はありません。

(その他)

既存装置のメンテナンスや改造及び部品販売が出荷台数の増加に伴い比較的安定的に推移し、売上高は399,722千円(前期比13.2%増)の結果となりました。

(品目別売上高)

品目	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
CVD装置	816,483	24.2	26.7
エッチング装置	1,729,067	51.2	16.9
洗浄装置	429,233	12.7	31.4
その他装置	-	-	-
その他	399,722	11.9	13.2
合計	3,374,507	100.0	1.8

なお、当社は装置により製造される半導体等電子部品をその用途により、LED・LD・DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex = 高密度波長多重伝送)関連のオプトエレクトロニクス分野、各種センサー・磁気ヘッド・高周波デバイスなどの電子部品分野、半導体パッケージ技術や表面洗浄技術などの実装・表面処理分野、有機ELや各種LCD(Liquid Crystal Display = 液晶表示素子)基板などの表示デバイス分野、その他分野、部品・メンテナンスに分類しており、その売上構成は次の通りであります。

(用途別売上高)

用途	売上高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
オプトエレクトロニクス分野	1,103,626	32.7	35.1
電子部品分野	1,100,454	32.6	32.9
実装・表面処理分野	271,540	8.0	30.0
表示デバイス分野	221,525	6.6	46.4
その他分野	277,637	8.2	42.3
部品・メンテナンス	399,722	11.9	13.2
合計	3,374,507	100.0	1.8

(2) キャッシュ・フローの状況

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は税引前当期純利益が412,741千円(前期比0.2%増)となり、売上債権の減少額135,289千円がプラスに寄与したものの、借入金の返済346,615千円(うち短期借入金純減少額100,615千円、長期借入金純減少額246,000千円)などにより、資金残高は前期末に比べ74,593千円減少し、当期末には1,170,333千円(前期比6.0%減)となりました。また、当期における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は405,525千円(前期比355.7%増)となりました。これは主に税引前当期純利益412,741千円(前期比0.2%増)、売上債権の減少額135,289千円、減価償却費83,822千円がプラスに寄与し、仕入債務の減少額が34,199千円であったためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は69,410千円(前期比55.2%減)となりました。その主な内容は定期預金の払出による収入1,675,112千円に対して、定期預金の預入による支出が1,694,444千円であったこと、有形固定資産の取得による支出が33,461千円、無形固定資産の取得による支出が16,651千円であったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は407,729千円(前期比32.1%増)となりました。これは、短期借入金の純減少額100,615千円、長期借入金の返済による支出296,000千円、長期借入金の借入による収入50,000千円と配当金の支払額61,114千円によるものです。

### (3) 次期の見通し

次期の見通しにつきましては、携帯電話やデジタル家電の需要拡大に伴う各種デバイスメーカーの設備投資を背景に、LED、半導体レーザーやレンズ向けのオプトエレクトロニクス分野及び電子部品分野向けの販売が引き続き業績を牽引すると考えられますが、新しい用途として有機 EL 基板への封止膜形成用 CVD 装置や三次元実装用途向け CVD 装置とエッチング装置のセット販売も期待をしているところであります。洗浄装置につきましては、中国、東南アジアを中心に販売を強化いたします。また、産官学のナノテク関連の研究開発分野での受注についても、政府の積極的な予算配分や景気の回復が追い風となって堅調に推移するものと見込んでおります。更には、研究開発用途向けの市場で利益率を維持し、量産用途向けの市場では利益率を柔軟に設定することで競争力を発揮し、売上高の拡大を目指します。売上総利益率は、設計段階からの標準化をより一層推進しコストダウンをはかり 50%を目標といたします。販売費及び一般管理費は、研究開発投資および中途採用人材に関する人件費に対して、引き続き資源の投入を予定するものの、固定費の増加要因は限定的と見ており、対売上高比率は低下できるものと予想しております。

以上の見通しにより、売上高は 4,400 百万円（当期比 30.4%増）、経常利益は 750 百万円（当期比 82.0%増）、当期純利益は 445 百万円（当期比 77.1%増）となる見込みであります。